

各 位

令和7年11月7日
株式会社ヒップ
(証券コード：2136)

独立行政法人日本学生支援機構が発行する「ソーシャルボンド」への投資について

株式会社ヒップ（代表取締役社長：田中 伸明、以下「当社」という）は、このたび、独立行政法人日本学生支援機構（以下、「同機構」という）が発行するソーシャルボンド（第81回日本学生支援債券、以下「本債券」という）への投資を決定しましたので、お知らせいたします。

「ソーシャルボンド」とは、社会的課題の解決に資するプロジェクト（ソーシャルプロジェクト）の資金調達のために発行される債券のことであり、グリーンボンドとともに、ESG⁽¹⁾投資の対象となります。同機構は、2023年4月、ソーシャルファイナンス・フレームワークについて、ICMA（International Capital Market Association／国際資本市場協会）が定義するソーシャルボンド原則に適合する旨、日本格付研究所（JCR）からセカンド・パーティー・オピニオンを取得しており、本債券は「ソーシャルボンド」として発行されます。

本債券の発行による調達資金は、同機構が担う奨学金事業の内、貸与奨学金の財源として活用されます。奨学金事業は、日本国憲法第26条や教育基本法第4条に定められる「教育の機会均等」や、国連の持続可能な開発目標（SDGs）⁽²⁾の内、目標4「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。」の達成に資する等、我が国の教育面の課題解決に貢献します。

当社は、設計開発に特化した技術サービスを提供し続け、本年9月に創立30周年を迎えました。技術者のための会社として「ハイブリッドな技術者の「ホーム」であり続ける。」をミッションに掲げ、技術者と顧客に選ばれる強い会社、技術者のキャリア形成を支援する会社として技術者価値の向上に取り組んでおります。当社事業にとって人材は最重要資産であり、とりわけ人材育成を含めた人への投資については重点項目として力を入れております。

今回の投資が、より多くの学生にとって夢を追い求める機会を広げ、次代を担うプロフェッショナルな人材として活躍する未来へとつながることを期待しております。

当社は、本債券を始めとしたソーシャルボンドへの投資を継続的に実施することで、今後も社会的責任を果たしてまいります。

〈本債券の概要〉

銘 柄	第81回日本学生支援債券
年 限	2年
発行額	300億円
発行日	令和7年11月7日

(1) ESGとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の英語の頭文字を合わせた言葉。「ESG投資」とはこれらの要素を重視・選別して行う投資のこと

(2) 持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年9月の国連持続可能な開発サミットにて採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が掲げる、加盟各国が2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットのこと

以 上